

AMI 互通性產業標準工作組會議記錄

紀錄：台灣智慧型電網產業協會秘書處

會議時間：104 年 9 月 21 日

出席代表：經濟部標檢局、台灣智慧型電網產業協會、Sensus Systems (UK) Limited、大同股份有限公司、工業技術研究院、中興電工股份有限公司、台灣富士通股份有限公司、四零四科技股份有限公司、玖鼎電力資訊股份有限公司、指旺科技股份有限公司、財團法人台灣電子檢驗中心、財團法人資訊工業策進會、康舒科技股份有限公司、智能電網國際股份有限公司、華新儀錶股份有限公司、意法半導體股份有限公司、達創科技股份有限公司

會議內容：本次工作組會議，目的係辦理先進讀表系統互通性產業標準提案審查會議，並針對 AMI 互通性標準-G3.PLC、AMI 互通性標準-ZigBee Pro 與 AMI 互通性標準- RFC6971 三項提案進行討論。本次會議亦邀請 Texas Instruments 與 NXP 的專家來針對現有封包切割位元組門檻進行說明與討論。另由提案單位針對 AMI 互通性產業標準工作組之審查意見，進行提案內容之修正與答覆。且於討論會後表決是否通過 AMI 互通性標準-ZigBee Pro 提案。

議題討論：

1. Texas Instruments 與 NXP 的專家說明現有封包切割位元組門檻
2. 資策會 G3-PLC 提案審查意見回覆與討論
3. 富士通 RFC6971 提案審查意見回覆與討論
4. 投票表決 AMI 互通性標準-ZigBee Pro
5. 臨時動議

會議結論：

1. 透過專家說明與討論，向兩家晶片廠商 Texas Instruments 與 NXP 初步確認其晶片封包切割位元組長度門檻均可以向下調整，建議將互通性標準-ZigBee Pro 草案 test case 關於封包切割位元組門檻限制內容依循原規範內文修改成可接受彈性調整惟加上 payload 建議值為 79bytes。並再安排資策會針對兩家廠商產品進行測試。專家提醒倘若未來引進第三家廠商，其晶片封包切割位元組長度小於現有設定值，則 Texas Instruments 與 NXP 的晶片仍可包容第三家的產品，但新進廠家的產品卻無法接收原設定值之產品所傳遞的訊息。
2. 資策會 G3-PLC 提案已依照審查委員建議完成規範翻譯並補足安全規範，目前尚未收到審查意見，預計於下次會議再提出審查討論。
3. 富士通針對 8 月 21 日委員提出的 RFC6971 提案審查意見進行答覆，並提供 MAC Layer 及 PHY Layer 相關說明文件，表示會再補充針對該文件所進行的變更說明文檔，同時也在進行蒐集、完善其餘說明文件。此提案於 Wi-Sun

技術審查時程規畫方面，目前持續與 Wi-Sun 聯盟聯繫欲加速進度，預計於 11、12 月完成審查成為公開標準。目前富士通於 Wi-Sun 聯盟的申請提案只針對 2.4GHz 的 Network Layer 及 MAC Layer (搭配 2.4GHz 的 PHY Layer)，並將曾屬於富士通的專利透過此申請公開至 Wi-Sun 聯盟上。

4. 經無記名投票表決通過互通性標準-ZigBee Pro 提案。(總票數為 20 票，有效票數 19 票：通過 14 票；不通過 5 票。監票人：四零四科技 趙洪誠協理)
5. 提議下次會議邀請郭芳楠副處長出席會議，釐清廠家會員及代表的疑慮，並說明台電對工作組制定之標準的看法與台電目前佈建狀況與方向建議，包括台電對於AMI系統未來擴大應用的方向同時說明其未來採納通訊技術的可能發展趨勢。